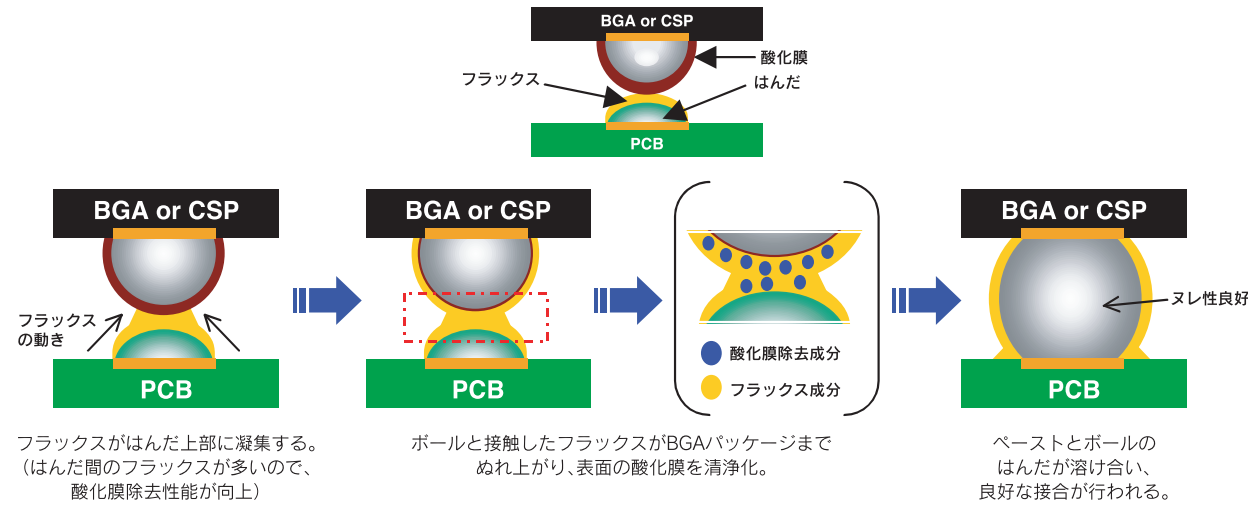


### BGA、CSP部品のボールに対するぬれ性向上

BGA,CSP部品のはんだボールに対するソルダペーストのぬれ性は、部品の接合性、またははんだ中のボイドの発生へと繋がります。フラックス中の樹脂、活性剤の最適化により、はんだボールへのソルダペーストのフラックスのぬれ上がり性を向上させました。



### 微小パターン部のぬれ性を向上

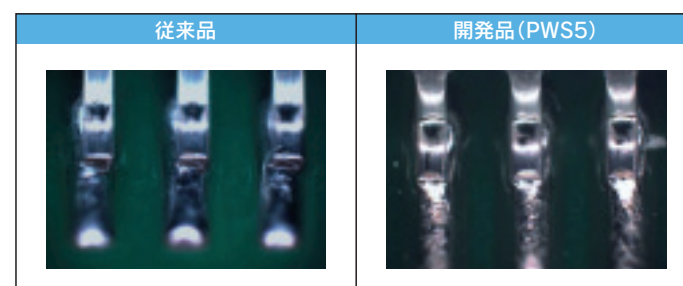
接合部の微細化は、今後更に進むと考えられます。そのため、微小印刷部でのぬれ性確保は、非常に重要です。0.25mmφの銅ランド上に0.225mmφでペーストを印刷し、通常プリヒートと高温プリヒートの条件でリフローを行い、ぬれ性を比較しました。

通常プリヒートプロファイルの場合		高温プリヒートプロファイルの場合	
従来品	開発品 (PWS5)	従来品	開発品 (PWS5)

開発品は従来品と比較して、ぬれ上がり性が格段に向上しました。

### リード端面へのぬれ上がり性を向上

一般に、ぬれが非常に悪いと言われているリード端面に対しても、開発品は優れたぬれ上がり性を示します。0.5mmピッチのQFPリード端面へのぬれ上がり性を従来品と比較しました。リフロー条件は高温プリヒート条件で行いました。

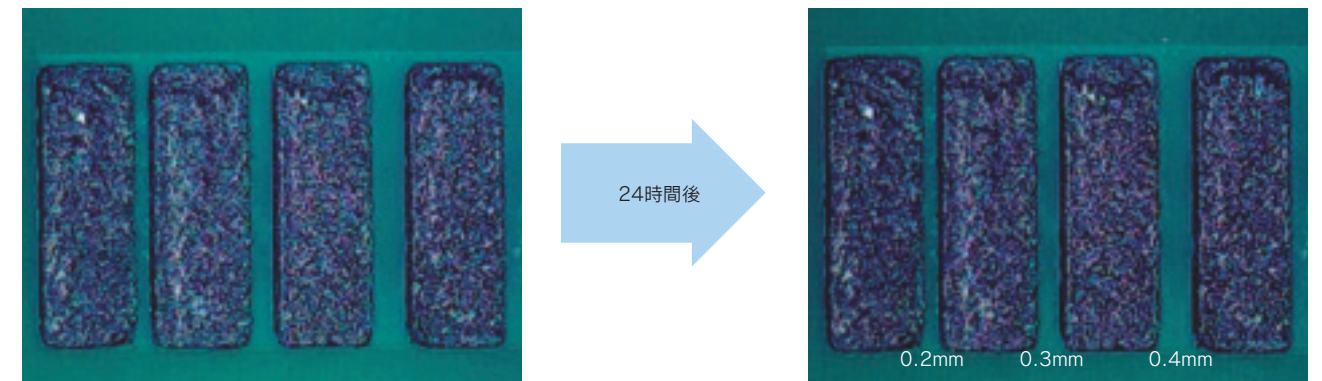


開発品は従来品と比較して、ぬれ上がり性が格段に向上しました。

### 各種性能試験結果 (JIS準拠)

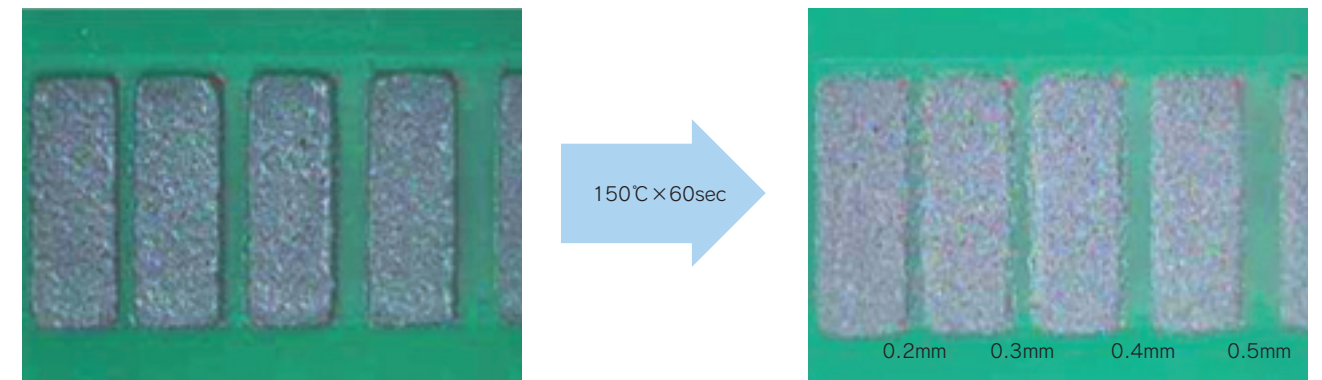
#### 印刷ダレ性試験

試験方法: JIS-Z-3284 準拠 目的: 24時間室温放置後のソルダペーストのダレ性を確認 結果: 印刷ダレなし



#### 加熱ダレ性試験

試験方法: JIS-Z-3284 準拠 目的: 加熱後のソルダペーストのダレ性を確認 結果: 0.3mm以上のギャップでダレ発生なし



#### 銅板腐食試験

試験方法: JIS-Z-3284 準拠 目的: 加湿下でのフラックス残渣の腐食度合いを確認 判定: 初期と比べ変色なし 結果: 腐食なし

